

PRESSEMITTEILUNG

PRESSEMITTEILUNG10. September 2026 || Seite 1 | 5

Von der Pilotlinie zur industriellen Umsetzung: FIRST by FMD bringt die Entscheider:innen für Europas Halbleiter-zukunft zusammen

Europa hat Milliarden in die Halbleiterindustrie investiert. Nun entscheidet sich, wie aus den im Rahmen des EU Chips Acts aufgebauten Pilotlinien industrielle Wertschöpfung entsteht. Darüber diskutieren führende Vertreter:innen aus Industrie, Forschung und Politik bei »[FIRST by FMD](#)« am 30. September und 1. Oktober 2026 am EUREF-Campus Berlin.

Die APECS-Pilotlinie für Advanced Packaging und Heterointegration bietet Zugang zu Design, Entwicklung, Test und Pilotproduktion und schafft damit eine Brücke von der Forschung zur industriellen Anwendung. Dass dieser Transfer nur durch ein enges Zusammenspiel von Wissenschaft und Industrie gelingen kann, unterstreicht Prof. Dr. Holger Hanselka, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft: »Europe's future in microelectronics will be decided not just by roadmaps and in the labs, but by joint efforts of industry and scientific organizations to rapidly translate research excellence into scalable industrial technologies.«

Von der Forschung in die Produktion: Wie Europa Forschung und Investitionen in industrielle Stärke übersetzen kann

Welche politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen und auf welche technologischen Stärken Europa setzen kann, steht im Mittelpunkt des neuen Trendforums FIRST by FMD. Verschiedene Sessions, Panel Diskussionen, technologische Deep Dives zu den Leitthemen, die das europäische Halbleiterökosystem bewegen, sowie strategische Spotlights verbinden unterschiedliche Perspektiven. Dabei geht es thematisch nicht nur um den Zugang zu Infrastruktur, sondern auch um verlässliche Rahmenbedingungen für den anschließenden Weg in die industrielle Fertigung.

Michael Hosemann von Siemens Healthineers erklärt: »Supporting process development capabilities is much needed and appreciated. However, we also need policies allowing for flexible scale-up and sustainable long-term supply.« Die strategische Bedeutung solcher Rahmenbedingungen unterstreicht Alexandra-Gwyn Paetz vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR). »Germany's position in microelectronics has far-reaching implications for our innovative strength – and thus also for our industrial competitiveness, technological sovereignty, and economic resilience. Our High-Tech Agenda therefore strengthens microelectronics as a key enabling technology.«

PRESSEINFORMATION

10. September 2026 || Seite 2 | 5

Mit der Weiterentwicklung des EU Chips Acts stellt sich daher auch die Frage, welche Weichen Europa jetzt für die nächste Phase seiner Halbleiterstrategie stellen muss. Entscheidend ist, dass der Chips Act 2.0 nicht nur Forschung und neue Produktionskapazitäten fördert, sondern auch die industrielle Skalierung und langfristige Wertschöpfung in Europa unterstützt.

Carsten Salewski von Viscom formuliert eine konkrete Erwartung: »In my view 'EU added value' in Chips Act 2.0 must be EU made production equipment for 'new or substantially upgraded facilities for electronics manufacturing or integration'.«

Advanced Packaging, Chiplets und Design: Wo Europas Chancen liegen

Europas Chance liegt besonders darin, vorhandene Kompetenzen in den Technologiefeldern Advanced Packaging, Heterointegration, Chiplets und Chipdesign auszubauen, um sich strategisch zu positionieren.

»Advanced Packaging is the next battlefield. Europe needs packaging sovereignty alongside fab sovereignty. Laser beam-shaping enables chiplet integration at scale«, erklärt Marcel Schäfer von TRUMPF.

Thomas Heurung von Siemens EDA ergänzt: »Speed is of the essence in semiconductors. AI-enabled EDA and Europe's chip design platform help startups reach PoC, funding and customers faster.«

Pressekontakt Romy Zschiedrich, Leiterin Kommunikation

E-Mail: romy.zschiedrich@mikroelektronik.fraunhofer.de | Mobil: +49 173 5434 126

www.forschungsfabrik-mikroelektronik.de

Wie diese Technologien und die dafür notwendige Infrastruktur zur europäischen Halbleiterstrategie beitragen können, ist fester Bestandteil des kuratierten FIRST-Programms. Dies wird auch auf der Demo Street dargestellt. Hier können Besucher:innen Technologien und konkrete Anwendungen aus den Bereichen Power, Advanced Packaging, Radio Frequency, MEMS, Sensorik und Photonics erleben und mit den Expert:innen vor Ort ins Gespräch kommen.

PRESSEINFORMATION

10. September 2026 || Seite 3 | 5

Die führenden Akteure aus der Mikroelektronikbranche

FIRST bringt führende Akteure des gesamten europäischen Halbleiterökosystems zusammen: Halbleiterhersteller, wie GlobalFoundries, Intel, STMicroelectronics, NXP oder UMS treffen auf Equipment- und Integrationsanbieter wie ASML, ASMPT, TRUMPF, Viscom oder Comet. Siemens EDA, die EuroCDP und das Netzwerk Chipdesign Germany adressieren die europäische Design-Infrastruktur, während Bosch, Audi, Siemens Healthineers, Diehl Defence, HENSOLDT oder Thales die Anforderungen wichtiger Anwenderindustrien in den Diskurs einbringen. Vertreter:innen der Europäischen Kommission, des Chips Joint Undertaking und des BMFTR sowie von der FMD und von Hochschulen ergänzen die Perspektiven aus Politik und Forschung.

Medienvertreter:innen sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen und können sich ab sofort unter <http://www.first-by-fmd.de> akkreditieren.



Pressekontakt Romy Zschiedrich, Leiterin Kommunikation

E-Mail: romy.zschiedrich@mikroelektronik.fraunhofer.de | Mobil: +49 173 5434 126

www.forschungsfabrik-mikroelektronik.de

Über die APECS-Pilotlinie

Im Rahmen des EU Chips Acts baut die FMD mit APECS in den kommenden Jahren eine umfassende Pilotlinie für resiliente und vertrauenswürdige heterogene Systeme auf, die die Innovationsfähigkeit der europäischen Industrie in ihrer gesamten Breite fördert. Durch die Aktivierung neuer Funktionalitäten im Rahmen der »System Technology Co-Optimization« (STCO), ein end-to-end Design sowie Pilotproduktionskapazitäten ermöglicht die Pilotlinie die Weiterentwicklung von Innovationen von der Forschung zu praktischen, skalierbaren Fertigungslösungen. Darüber hinaus bietet APECS einen One-Stop-Shop für Kunden in praktisch allen klassischen vertikalen Industriebranchen, einschließlich Großunternehmen, KMU und Start-ups. APECS bringt die Kompetenzen, Infrastrukturen und das Know-how von zehn Partnern aus acht europäischen Ländern zusammen. In Deutschland sind zwölf Institute der Fraunhofer-Gesellschaft (Projektkoordinator) und zwei Institute der Leibniz-Gemeinschaft an der Pilotlinie beteiligt. Umgesetzt wird APECS von der FMD. Im Rahmen von APECS wurde auch FIRST by FMD als europäisches Entscheider- und Trendforum für Mikroelektronik initiiert. Mehr Informationen finden Sie unter <https://www.apecs.eu/>

PRESSEINFORMATION

10. September 2026 || Seite 4 | 5

Über die Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD)

Die FMD als Kooperation von 13 Fraunhofer-Instituten mit den Leibniz-Instituten FBH und IHP ist der zentrale Ansprechpartner für alle Fragestellungen rund um die mikro- und nanoelektronische Forschung und Entwicklung in Deutschland und Europa. Als One-Stop-Shop verbindet die FMD wissenschaftlich exzellente Technologien und Systemlösungen ihrer kooperierenden Forschungsinstitute zu einem kundenspezifischen Gesamtangebot. Unter dem virtuellen Dach der FMD entstand somit 2017 einer der größten Zusammenschlüsse dieser Art mit inzwischen mehr als 5500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer einzigartigen Kompe-

Pressekontakt Romy Zschiedrich, Leiterin Kommunikation

E-Mail: romy.zschiedrich@mikroelektronik.fraunhofer.de | Mobil: +49 173 5434 126

www.forschungsfabrik-mikroelektronik.de

tenz- und Infrastrukturvielfalt. Seit 2024 ist FMD eine eingetragene Wortmarke der Fraunhofer-Gesellschaft. Mehr Informationen finden Sie unter www.forschungsfabrik-mikroelektronik.de

PRESSEINFORMATION

10. September 2026 || Seite 5 | 5

Pressekontakt Romy Zschiedrich, Leiterin Kommunikation

E-Mail: romy.zschiedrich@mikroelektronik.fraunhofer.de | Mobil: +49 173 5434 126

www.forschungsfabrik-mikroelektronik.de
